**第二十一届中国覆铜板技术研讨会**

**邀 请 书**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2020年11月28日至11月30日，在广东省四会市“岭南东方酒店”举办“第二十一届中国覆铜板技术研讨会”。

本届研讨会的主题为“ **加大技术创新 克难行稳致远** ”。本届大会是在全球经济形势仍然复杂严峻、覆铜板产业发展与市场格局不确定性加大的形势下召开。如此形势也给我国覆铜板行业加快高端技术突破的步伐，产品升级换代下新市场的开拓带来新机遇 。本届研讨会着重研讨技术创新的新进展，交流市场需求的新趋势，展现覆铜板用原材料及设备的新成果，对促进产业链健康发展具有重要的意义。

自2000年CCLA创办并每年举办的“中国覆铜板技术研讨会”，已经成为我国覆铜板制造业中最高端的技术交流盛会。本届大会将邀请覆铜板行业及其上下游业界多位专家，就CCL技术与市场的热门话题作精彩报告。还有来自国内覆铜板行业及上下游行业的专家、技术人员呈献的优秀论文。并在大会召开期间，隆重颁发本届研讨会的“CCLA杯优秀论文奖”，组织代表参观承办单位。

**热忱欢迎覆铜板行业及上下游企业代表、业界人士届时光临。**

**热忱欢迎关注覆铜板行业发展的各界人士、机构光临此盛会。**

**参会代表，必须遵守大会举办地政府的防疫相关规定。**

**主办单位及联络资讯：**

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会覆铜板分会 李 琼 021-54179011-605

**承办单位：**

广东同宇新材料有限公司

**协办单位：**

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

广东省电路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

湖南省电子电路行业协会（HNPCA）

台湾电路板协会（TPCA）

**赞助单位：**

南亚新材料科技股份有限公司 山东圣泉新材料股份有限公司

诺德投资股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司

广东生益科技股份有限公司 建滔积层板控股有限公司

南通凯迪自动机械有限公司 江苏瀚高科技有限公司

江苏东材新材料股份有限责任公司 苏州巨峰新材料科技有限公司

南通图海机械有限公司 西安昱昌环境科技有限公司

珠海镇东有限公司 广东英斯派克视觉科技有限公司

广州君亮模具科技有限公司 鸿安（福建）机械有限公司

无锡阿尔泰钢业有限公司 美国微觉视检测技术公司

梅州市威利邦电子科技有限公司 咸阳威迪机电科技有限公司

陕西宝昱科技工业有限公司 江西晨光新材料股份有限公司

浙江双元科技开发有限公司

赞助单位征集中 ••••••

**会议日程:**

“第二十一届中国覆铜板技术研讨会”：会期2020年11月28日～30日。11月28日全天报到，11月29日全天报告（8:30～18:00），11月30日上午8:20～12:00参观广东同宇新材料有限公司、四会市电子信息产业园，下午疏散。11月29日报告的具体安排附后。

**会议费用：**

**费用包括**：会务费、资料费、餐饮费等。

**会费标准：**已交会员费单位1500元/人，未交会员费单位代表及非会员单位代表1800元/人。参会代表可提前将会务费汇至协会账户，如参会人员有变动，会后办理退费或报到现场补交。

**住宿：**参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间，标间420元/晚/间（含双早），单间420元/晚/间（含早餐），费用自理。

**预定住宿联系人：欧庆成，电话：18128082533**

**付款方式：**

**帐 户: 中国电子材料行业协会**

**开户银行: 工行北京香河园支行**

**账 号: 0200 0191 0900 0125 724**

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**会议地址：**

四会市岭南东方酒店（广东省四会市贞山大道33号）

酒店联系电话：0758-3118888

**会议酒店交通指南：**

**飞 机：**广州白云国际机场距会议酒店约65公里，乘车约70分钟到达酒店。

**高 铁：**肇庆东站距离会议酒店约13公里，乘车约30分钟到达酒店。

**自驾车**：两广高速转广佛肇高速行至莲花出口下高速，出口至酒店约10分钟。

**注：本次会议承办单位提供接送站服务，接送站时间安排如下：**

**接站时间：**11月28日，12:00～24:00，广州白云国际机场、肇庆东站 ，每两小时一班中巴车接送参会代表至酒店。

**送站时间：**11月30日，8:00/10:00、13:30/16:00，分别安排两班车，送参会代表至广州白云国际机场、肇庆东站。

请参会代表合理安排出行时间。

**会务组联络方式：**

联系人：王晓艳 13609146084 ，029-33335234 ，13369111960

董榜旗 15667263899

协会微信：15667246308

E-mail: [ccla33335234@163.com](mailto:ccla33335234@163.com)

网 站：[www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn/)



《第二十一届中国覆铜板技术研讨会》组委会

2020年11月 9 日

**《第二十一届中国覆铜板技术研讨会》**

**会议回执**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | |  | | | | **订房数量** | |
| **代表姓名** | | **职 务** | **手 机** | **电 话** | **E-mail** | **单人间** | **双人间** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | |
| **开票信息： 名 称：**  **纳税人识别号：**  **地 址、电 话：**  **开户行及账号：** | | | | | | | |
| **备注** | **1. 房源有限，计划在四会市岭南东方酒店住宿的代表，务请于2020年11月20日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：欧庆成经理** **电话18128082533 。**  **2.请参会代表准确填写回执表各项信息，**[**将回执于11月25日前发至**](http://将回执于10月15日前发至)[**ccla33335234@163.com**](mailto:ccla33335234@163.com)**或协会微信：15667246308 。**  **3.需要了解研讨会最新动态请登录：**[**www.chinaccl.cn**](http://www.chinaccl.cn) **或者直接联系会务组。** | | | | | | |

**2020年11月29日会议日程 （暂定）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **报告地点、报告人及报告题目** | **主持人** |
| **报告地点 《金色大厅》** | | |
| 8:30  ～  12:00 | 中国电子材料行业协会副理事长、覆铜板材料分会理事长 **张东： 致开幕词** | **张 东** |
| 中国电子电路行业协会领导**：致词** |
| 广东省四会市领导**：致词** |
| 广东同宇新材料有限公司总经理 **张驰： 致欢迎词** |
| 颁发2020年“CCLA杯”优秀论文奖 （获奖人员合影留念） |
| 四会市招商推介 **《电子产业园+万洋众创城》** |
| **【特邀报告】**华为技术有限公司PCB首席工艺专家 **高峰： 《5G通信技术新发展及对覆铜板的新需求》** |
| **【特邀报告】**中国电子科技集团公司第5研究所分析中心 高级工程师 **何骁;**  **《高性能CCL板级应用验证中的典型可靠性问题及应对》** |
| **【特邀报告】**博敏电子股份有限公司技术中心总监**陈世金 《光模块基板工艺发展新特点及对基板材料性能的要求》** |
| 广东同宇新材料有限公司总经理 **张驰**： **《待定》** |
| 林州致远电子科技有限公司副总经理 **王贻超： 《基于工业大数据和人机融合智能的覆铜板智能工厂建设和发展》** |
| 12:00～13:30 | **自助餐 《金色大厅前厅》** | **董榜旗**  **林辽远** |
| **CCL产品与技术报告专场 《金色大厅》** | | |
| 13:30～  18:00 | 南通图海机械有限公司总经理 **邵蔚： 《浅析CCL行业废气治理与能源回收管理》** | **师剑英** |
| 广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术中心研究所所长 **方克洪：**  **《高CAF可靠性Tg150覆铜板的开发》** |
| 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂研发工程师 **郑强： 《LED封装用白色覆铜板的研究》** |
| 国家电子电路基材工程技术中心、广东生益科技股份有限公司工程师 **陈振文：**  **《极低热膨胀系数和中等损耗的覆铜板开发及其在多层板中的应用研究》** |
| 麦可罗泰克（常州）产品服务有限公司检验室经理 **戈昕： 《CAF测试表象与失效现象》** |
| 国家电子电路基材工程技术中心、广东生益科技股份有限公司工程师 **范华勇： 《一种高频导热覆铜板的制备》** |
| 陕西生益科技有限公司研发工程师 **郑浩：** **《DOE设计在导热覆铜板中应用研究》** |
| **【特邀报告】**中电材协覆铜板材料分会资深专家、教授级高工 **师剑英： 《偶联剂及相容剂在CCL中的应用》** |
| **CCL用原材料报告专场 酒店《翡翠厅》** | | |
| 13:30～  18:00 | 中国科学院长春应用化学研究所博士、副研究员 **郭海泉： 《聚酰亚胺结构设计及其高频介电性能》** | **杨中强** |
| 教育部纳米矿物材料及应用工程研究中心、中国地质大学（武汉）材料与化学学院教授 **曾鸣：**  **《高频低介电性氧化石墨烯/苯并噁嗪纳米复合树脂的制备、表征以及石墨尺寸的影响研究》** |
| 国家绝缘材料工程技术研究中心、四川东材科技集团股份有限公司研究院副院长 **周友：**  **《马来酰亚胺封端热固性聚苯醚树脂的合成及性能研究》** |
| 广东同宇新材料有限公司研发工程师 **徐国正： 《硅烷改性聚苯醚在覆铜板中的应用》** |
| 江汉大学化工与环境学院研究生 **蔺亚辉： 《改性聚苯醚在高频覆铜板中的应用》** |
| 山东圣泉新材料股份有限公司研发经理 **刘盈： 《苯并噁嗪树脂的低介电改性研究》** |
| 山东金宝电子股份有限公司副总经理 **杨祥魁： 《挠性覆铜板用铜箔的技术现状与趋势》** |
| **【特邀报告】**国家电子电路基材工程技术中心主任 **杨中强： 《高频高速覆铜板对原材料性能的要求》** |
| 18:30～20:30 | **广东同宇新材料有限公司 招待晚宴 《金色大厅》** | **林辽远** |

**11月30日 上午8:30～12:00参观“广东同宇新材料有限公司”、“四会市电子信息产业园”。**